



H2405 环氧包封材料

产品描述

H2405 是一款专为细间距邦定工艺开发的可高速流动，高效渗透孔隙，满足标准无铅回流制程的环氧包封材料。材料固化后，高的玻璃化转变温度和超低的热膨胀系数，为芯片和元件提供了优异的低应力保护效果。

产品特性

项目	规格
化学类型	改性环氧树脂
外观	黑色液体
组分	单组分
固化方式	加热
典型应用	用于 BGA、芯片的不可返修底部填充或包封制程

产品优点

- 超低 CTE;高 T_g 值，耐温性好
- 高速流动，高效渗透
- 快速固化，与大多数助焊剂残留物兼容性好
- 优异的可靠性

未固化时性能

项目	典型值	备注
粘度 cps	40,000-60,000	GB/T 2794
比重 g/ml	1.8	GB/T 13354
操作时间	24 小时	@ 25° C



固化后性能

在推荐条件下固化：

项目			典型值	备注
物理性能	硬度 shore D		≥90	GB/T 2411
	线性膨胀系数	a1 ppm/° C	18	TMA
		a2 ppm/° C	70	
	玻璃化转变温度 (Tg) °C		150	TMA
	线性收缩率%		<0.4	ASTM D2566
	拉伸强度 Mpa		58	GB/T528
	拉伸剪切 FR4-FR4, 25°C, Mpa		>8	GB/T7124
	杨氏模量 GPa		13.8	GB/T1447

固化条件

推荐固化条件

凝胶时间	≥10 min @120° C
推荐固化	30min @ 120°C + 90min @ 160°C

注意：固化温度高于 170°C 或者低于 100°C，可能造成固化物性能的变化，因此不予推荐。具体固化时间的长短，需要根据使用现场的实际因素来决定，比如组件的三维形态，基材的性质、胶层的厚度控制，以及烤炉的传热效率等等。

使用方法

- 1、使用前从冰箱中取出回温:推荐回温时间: 30cc/支 建议回温时间 0.5-2h。推荐回温条件:温度 23-28° C, 湿度 65%RH 以下。
- 2、回温温度未达到室温时请勿打开包装。打开包装前请确认外包装上没有水分。
- 3、推荐使用条件:请在温度 28° C 以下, 湿度 65%RH 以下使用。
- 4、开封后请在 24 小时内用完。使用中避免污染, 未用完的胶, 不推荐被重复冷冻再回温使用。
- 5、未固化的胶粘剂可用与环氧树脂相溶的溶剂清洗。
- 6、有关此产品的安全事项, 请参考 MSDS



包装规格

- 30ml/支
- 根据客户要求

产品储存

本产品最佳存储条件：-40° C 以下，存储期 6 个月。

将产品存贮于未开封的原装容器内，并存放在干净、干燥的区域。存储信息同时标注于产品外包装标签。为防止未使用产品受到污染，请不要将任何材料放回原装容器。本公司不对在所述情况以外的条件下被污染或储存的产品承担责任。更具体的保存期限信息，请咨询 Hanlicon 应用工程师。

注:本文中所含的各种数据仅供参考。对于任何人采用我们无法控制的方法得到的结果，我们恕不负责。自行决定把本产品用在本文中提及的产品应用外，及未采取本文中提及的措施来防止产品在贮存和使用过程中可能发生的损失和人身伤害都是用户自己的责任。本公司明确声明对所有因销售公司产品或特定场合下使用本公司产品而出现的问题，包括针对某一特殊用途的适用性问题，我们不承担责任。公司明确声明对任何必然的或意外损失都不承担责任。建议用户每次在正式使用前都要根据本文提供的数据先做实验。

湖南创瑾科技有限公司

中国湖南省长沙市宁乡经济技术开发区谐园北路

中国长沙智能终端产业园 5 号栋

Tel: +86-731-87827556

www.trumjin.com